

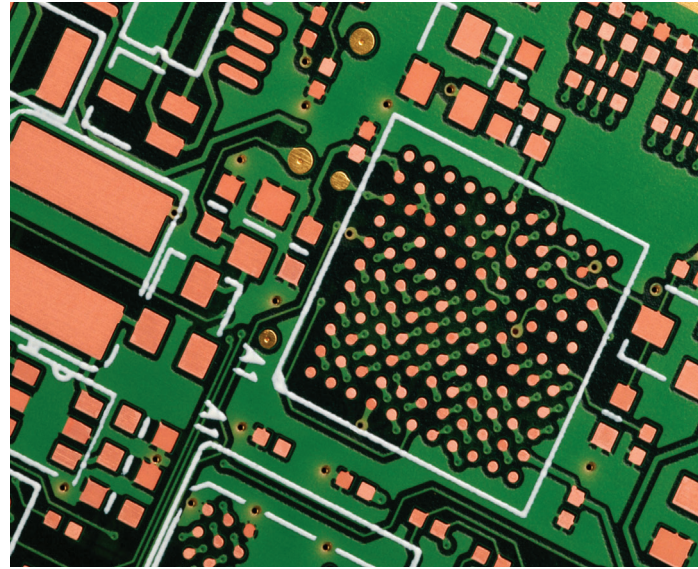
ENTEK Plus HT

有机保焊剂

电路板业界应用最广泛, 深受业界信赖的OSP

ENTEK Plus HT 为电路板业界应用最广泛的OSP, 深受业界信赖。适用于无铅制程的杰出表面处理。经过多次无铅无铅回流焊仍保持卓越的焊锡性, 具有较高可靠性的BGA焊接结合力。

ENTEK Plus HT制程满足无铅装配的要求, 同时维持铅锡共熔和制程处理之性能。该制程特别适合混合金属应用, 例如化学沉镍金 (ENIG)。该OSP可选择性地沉积在铜上, 避免金质连接器或金属散热器受到污染。



主要特性优点

- 汽车电子量产验证的行业领先最终表面处理
- 专利的预浸可将铜-锡扩散降低高达65%
- 容许多次无铅回流焊装配
- 行业中最长的保质期
- 独特的晶体结构可抵抗锡须的形成



MacDermid Enthone

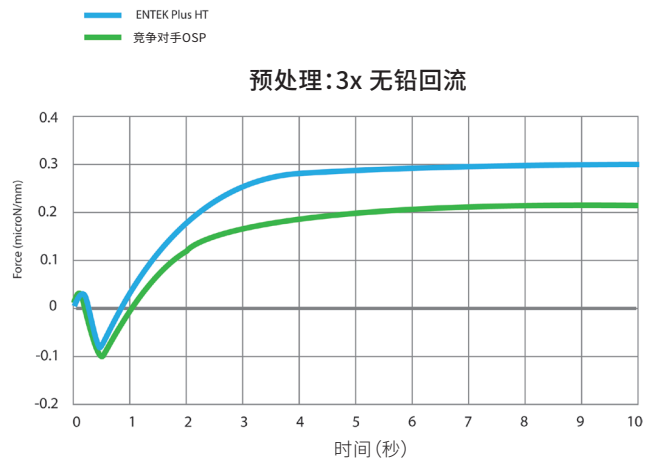
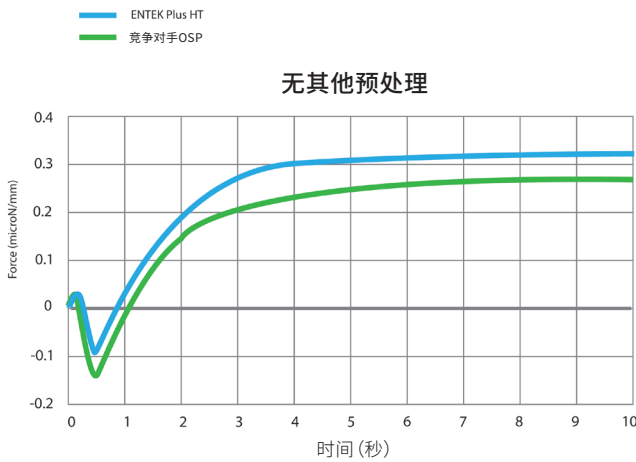
CIRCUITRY SOLUTIONS

ENTEK Plus HT

有机保焊剂

卓越的沾锡性能

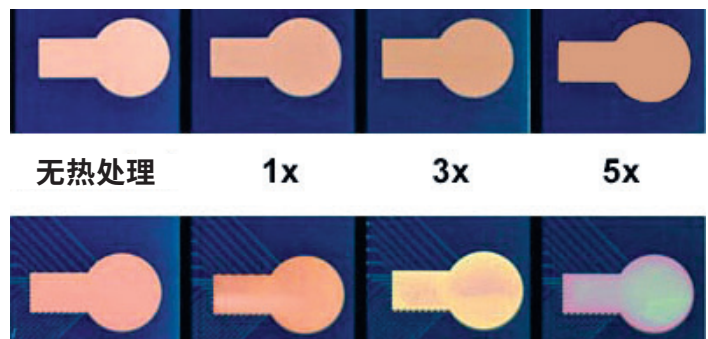
即使经过三次无铅回流(260°C), ENTEK Plus HT仍一再的显示比竞争对手 OSP表现更为卓越的沾锡天平测试结果。如下图所示, ENTEK Plus HT清楚的显示了沾锡更快, 沾锡最大值 (mN / mm) 明显更高。与竞争对手和其它仿造OSP相比, 这些是 ENTEK Plus HT对铜面优异的保护和维持其可焊性的关键指标。采用ENTEK Plus HT可获得优异的可焊性, 从而降低不良率和报废率, 提高可靠性和首次通过良率。



改进的外观

如右图所示, 与新一代OSP竞争者相比ENTEK Plus HT显然呈现了更完美的最终表面处理, 经过多次无铅回流仍保持卓越的可焊性。

仿造 OSP 相比, 仿造OSP显示更差的结果。



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.
® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.